



VECTECH BGA900A.

全紅外線 BGA 維修拆焊設備

VECTECH BGA900A 維修工作站，該系統採用微處理器控制和紅外線溫度感測器技術，能夠安全、精確的對表面黏著元件進行維修拆焊，並可通過拆焊溫度軟體 IR Soft 經由電腦連線，對整個維修零件的拆取、迴焊過程中進行控制，記錄其全部溫度、時間等資料，滿足現代電子工業更高的溫度要求，是電子工業領域最具價值的電子工具。

VECTECH BGA900A 具有精確的解焊及迴焊元件時，非接觸的紅外線溫度感測器和紅外線加熱系統。在任何時間，拆焊過程都經由非接觸的紅外溫度感測器監測，不受作業環境溫度的變化及冷機、熱機的影響，提供一致性最佳的溫度控制，拆焊良率可達 99% 以上。

BGA900A 上部紅外線加熱器，提供 720W 的加熱功率，底部為 1600W 紅外線陶瓷加熱器，適用於大、小 PC 板及無鉛錫球等條件所有的應用；為了實現無鉛焊接所需要更嚴謹的溫度視窗要求，使 PC 板及其整個封裝溫度得到有效的控制。BGA900 採用閉環控制迴焊技術，其精確溫度視窗，均勻的熱源分佈和適當的峰值溫度可實現高可靠度的無鉛迴焊。

BGA900A 採用紅外線溫度感應技術和閉環控制原理，具有精確的解焊元件非接觸的紅外線溫度感測器和中等波長的上部及底部紅外線加熱器。在解焊、迴焊過程都經由非接觸式紅外線感應器監測 BGA 零件溫度，並給予最佳的溫度控制。其中等波長的紅外線加熱器，具有均勻和安全的加熱系統所需求的功率和靈活性，對於 PCB 需求大熱量及無鉛錫零件拆、焊時的高溫要求等，都可輕易完成 Rework 元件的拆取及迴焊。全程無風式作業，不需更換不同零件尺寸的熱風頭。

BGA900A 系統設有 10 組工作參數模式，可編輯溫度及時間控制，對每一種模式都可進行參數修改。連線電腦操作，可儲存百組以上的拆焊參數，並可於電腦上進行設定溫度及時間參數的修改。對於專業的技術人員，是一台完整理想的 BGA 維修拆焊設備工作站。



VECTECH BGA900A 產品規格

双紅外線 BGA 維修拆焊設備規格：

1. 總功率：2400W (max)
2. 底部加熱器功率：1600W (紅外線陶瓷加熱器)
3. 上部加熱器功率：720W (紅外線發熱管，波長約 2~8 μ m，尺寸：60 mm*60 mm)
4. 底部熱幅射加熱尺寸：260 mm*260 mm
5. 上部加熱器可調範圍：20 mm ~ 60 mm
6. 電腦軟體 IR Soft：標準 RS-232C (可與電腦連線)
7. 紅外線溫度感測器：0~300 $^{\circ}$ C (測溫範圍)
8. USB 介面：輸出 5V DC/1A，接 USB 照明設備
9. 最大 PC 板尺寸：420 mm*500 mm
10. 最大零件尺寸 BGA：60*60 mm
11. 保險絲：12A (230V)
12. 輸入工作電壓：AC230V / 12A / 50~60Hz (單相 / 需接地插)
13. 外觀尺寸：800 mm*580 mm*520 mm
14. 重量：14.3 kg